

Prüfbericht

Auftragsdaten

Kunde:	N/A	Eingangsdatum Bauteile:	N/A
Bestellnummer:	N/A	Kundenauftragsnummer	N/A

Test Sample Informationen

Hersteller:	Texas Instruments	Typbezeichnung:	UCC3809DTR-2
Gehäuse:	8-SOIC	Bauteilbeschreibung:	Off-Line Converter
Herkunftsland:	MX	Menge:	5700
Lot Code:	N/A		
Date Code:	2228		

Testumgebung Labor

Temperatur:	20°C – 25°C	Luftfeuchtigkeit:	30% RH – 40% RH
-------------	-------------	-------------------	-----------------

Zusammenfassung

Allgemeine Zusammenfassung:	Die Bauteile wurden als ungenutzt eingestuft und nach dem Referenzstandard als akzeptabel bewertet.
-----------------------------	---

Dieser Report wurde
erstellt durch:

Michael Mendoza

Geprüft durch:

Horst Fischer

Hinweis:

Dieser Report wurde elektronisch erzeugt. Kopien, auch von Teilen, sind nur nach Genehmigung durch die Components at Service GmbH zulässig.

Erstellt am:

Testüberblick						
Testbeschreibung	Stkzahl getestet	Gut	Schlecht	Nicht ausgef.	Bemerkung	Prüfer
Verpackungsinspektion (SAE AS6081, 4.2.6.4.2.1)						
Zustandsprüfung	5700	5700				AA
Externe visuelle Inspektion (SAE AS6081, 4.2.6.4.2.2)						
Zustandsprüfung	3	3				AA
Gehäuse Inspektion (SAE AS6081 / IDEA-STD-1010-B)						
Dimensionsverifikation	1	1				AA
Lösungsmitteltest Beschriftung (SAE AS6081 4.2.6.4.3 A / 4.2.6.4.2 B)						
Beständigkeitsprüfung				✓		
Beschriftungstest mit Aceton (SAE AS6081 4.2.6.4.3 A / 4.2.6.4.2 B)						
Beständigkeitsprüfung	1	1				AA
Kratztest (SAE AS6081 4.2.6.4.3 A / 4.2.6.4.2 B)						
Beständigkeitsprüfung	1	1				AA
Oberflächentest NMP (SAE AS6081 4.2.6.4.3 A / 4.2.6.4.2 B)						
Oberflächentest Ergebnisse				✓		
Oberflächentest Dynasolve (SAE AS6081 4.2.6.4.3 A / 4.2.6.4.2 B)						
Oberflächentest Ergebnisse				✓		
Röntgeninspektion (SAE AS6081, 4.2.6.4.4)						
Inspektion Interner Aufbau	3	3				AA
Materialanalyse Röntgenfluoreszenz (SAE AS6081, 4.2.6.4.5)						
Analyse der Bestandteile	1	1				AA
Elektrischer Test (MIL-STD-883/750/202/883 / AS6171/7)						
Elektrischer Test Ergebnisse				✓		
Lötbarkeitstest (MIL-STD-883 Method 2003 / J-STD-002)						
Lötevaluation				✓		
Entkapselung (SAE AS6081 4.2.6.4.6)						
Chip-Analyse	1	1				AA

Dieser Report wurde erstellt durch:	Hinweis: Dieser Report wurde elektronisch erzeugt. Kopien, auch von Teilen, sind nur nach Genehmigung durch die Components at Service GmbH zulässig.	Erstellt am:
Michael Mendoza		
Geprüft durch:		
Horst Fischer		